

## V9 SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN

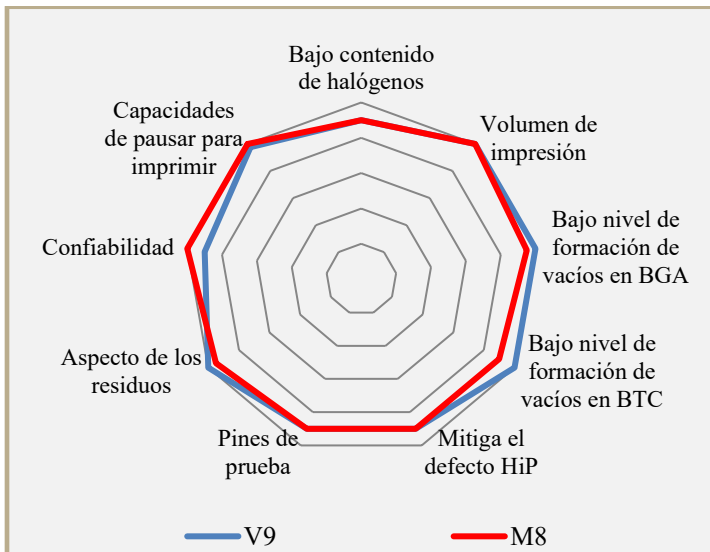
### CARACTERÍSTICAS

- Baja Formación De Vacíos: tan bajo como 1% en BGA y <5% en BTC
- Capaz de Imprimir de Forma Consistente con <0.66 AR
- Alta Confiabilidad (SIR)
- Proceso y Configuración de Equipo Similar a M8
- Cumple con La Norma REACH And RHS\*
- Disponible en SAC305 T4

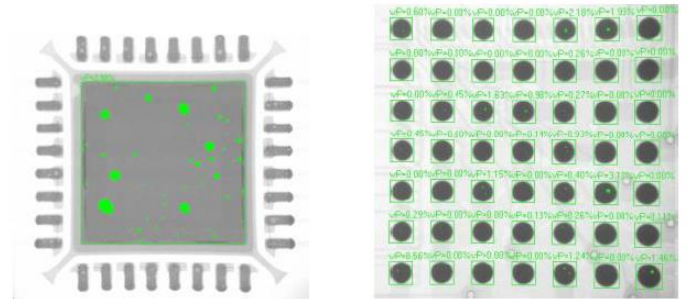
### DESCRIPCIÓN

La soldadura en pasta no clean V9 está formulada para obtener vacíos casi nulos en aplicaciones de soldadura en BGA, BTC y LED. Se obtiene una importante reducción de vacíos en todos los acabados de PCBs incluyendo ENIG, ImSn y OSP. V9 exhibe un rendimiento de impresión estable en dispositivos de características finas por más de 12hrs. Los residuos de V9 después del proceso son amigables con los pines de prueba ya que tienen altos valores de SIR.

### CARACTERÍSTICAS



\*Aleaciones libres de plomo.



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PARÁMETRO	TIEMPO	TEMPERATURA
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	6 Meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	1 Mes	< 25°C (< 77°F)

No añada pasta usada a la pasta que no ha sido utilizada. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta no usada bien cerrada con el tapón interno o la tapa en su sitio. Una vez abierta, la vida útil de la pasta para soldar dependerá del entorno y de la aplicación. Consulte las guías de uso de las pastas de AIM para obtener más información. Las condiciones de aleación y almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis V9 para obtener información específica del producto.

### LIMPIEZA

**Pre-reflujo:** El limpiador de estenciles de AIM elimina eficazmente la soldadura en pasta de los estenciles durante el proceso. El limpiador de estenciles se puede aplicar a mano o utilizar en equipos de limpieza bajo estencil. El limpiador de estenciles no seca la soldadura en pasta y mejora las propiedades de transferencia. No aplique una cantidad excesiva de limpiador de estenciles. No aplique el limpiador de estenciles en la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) durante el proceso, pero se puede utilizar como enjuague final del estencil.

**Residuos de flux posteriores al reflujo:** Pueden quedar residuos en el ensamblaje después del reflujo, pero no es necesario limpiarlos. Cuando la limpieza es obligatoria, AIM ha colaborado estrechamente con socios del sector para garantizar que los residuos se puedan eliminar eficazmente con agentes desfluxantes comunes. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la limpieza.

\*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.


## PERFIL DE REFLUJO

Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

## IMPRESIÓN

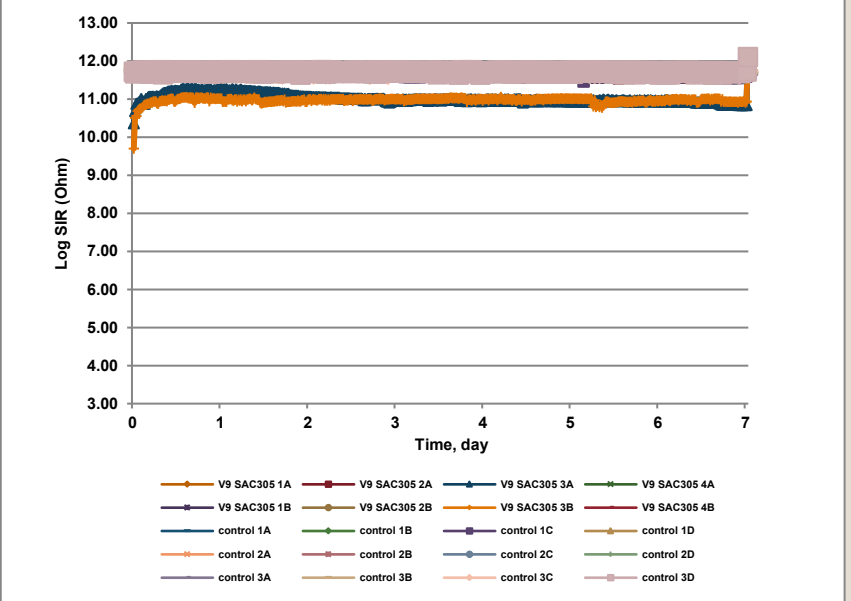
AJUSTES INICIALES RECOMENDADOS DE LA IMPRESORA - DEPENDIENDO DEL DISEÑO DE LA PCB Y DEL PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de espátula	0.4 - 0.7kg/25mm
Velocidad de la espátula	13 – 152 mm/seg.
Distancia de impresión (Snap-off)	En contacto 0.00 mm
Distancia de separación PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de separación PCB	3 - 20 mm/seg.

## RESUMEN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004A3.3	ROL0	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004 versión actual	ROL1	
NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	IMAGEN
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Haluros Cuantitativos	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.44% Cl: 0.0% Típico	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	


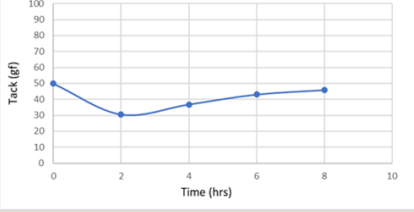
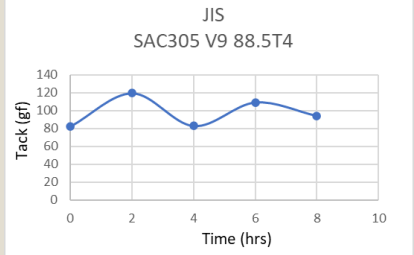
\*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	IMAGEN
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	Todas las mediciones en los patrones de prueba exceden 100 MΩ	
Flux sólidos, Determinación no volátil	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.14% Típico	
Determinación del valor ácido	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	139.03 mgKOH/g Típico	
Viscosidad (Malcom Viscosity)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	150-250 Pa·s Típico	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASA	
Depresión (Slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	

\*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

Prueba de dispersión	J-STD-004B 3.7.2 IPC-TM-650 2.4.46	PASA	
Bolas de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Fuerza de Adhesión (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 Típico	
Fuerza de Adhesión (Tack)	JIS Z 3284 Annex 9	82.5 gf Time 0 Típico	

\*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

**CONDICIONES DE USO** La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.